

5G网络摄像头CPU和DDR屏蔽罩导热硅胶片汇为

产品名称	5G网络摄像头CPU和DDR屏蔽罩导热硅胶片汇为
公司名称	汇为热管理技术（东莞）有限公司
价格	.50/个
规格参数	品牌:Huiwell 导热系数:5W/mk 厚度:0.5~13mm可选
公司地址	东莞市企石镇铁炉坑村湖滨南路
联系电话	18938207451

产品详情

导热硅胶片厂家汇为的HW-G500导热硅胶垫片是一款导热系数为5W/mk的高导热硅胶片，采用硅胶和导热陶瓷填料作为基材，它能解决大部分电子产品器件冷却散热的问题，它的表面自带弱粘性，具有一定的柔软性、压缩性以及优良的绝缘性，能够充分填充发热器件(如芯片)与散热器或壳体之间的空气间隙，完成出众的热量传递。同时还兼具减震、缓冲等作用，能够满足设备小型化及超薄化的设计要求，作为极具工艺性、导热性能极佳的填充材料而被广泛应用于电子电器产品中。

汇为热管理材料拥有业界最先进齐全的导热硅胶材料生产线，因此可以完全按照客户需求定制，包括但不限于以下参数：

A. 导热系数: 从1.5W/mk~5W/mk;

B. 厚度：从0.5~13mm

C. 硬度，颜色，粘性等

汇为热管理技术有限公司(Huiwell Thermal Management Tech)是国内最早从事热管理材料销售运营的公司之一,公司早期主要负责国际导热材料品牌在中国区的销售和服务。历经多年的行业积累和沉淀,转型热管理材料的设计开发、生产制造以及销售服务。公司目前分为热管理材料和整机散热设计两大事业集群,致力于为各个领域客户提供一站式热管理技术及产品解决方案。

汇为热管理材料事业部,研发及制造中心均坐落于中国智能制造的前沿阵地-东莞,主攻热界面材料(导热硅胶片材料、导热绝缘片、导热双面胶、导热凝胶等)以及电子隔热材料的设计、开发和生产。我们拥有目前业绩最先进的生产线,月生产导热硅胶片10KK/片。

汇为热管理材料支持“客需定制化生产”,以导热硅胶片为例,我们支持:导热系数从1.0W~5.0W/mk宽幅定制,尺寸厚度(0.5~13mm)定制,颜色定制,硬度定制.....总而言之,汇为热管理将以最优价格,最优品质,最优服务呈现给所有经销商、终端客户。